



性能特点

输出功率: +14 dBm

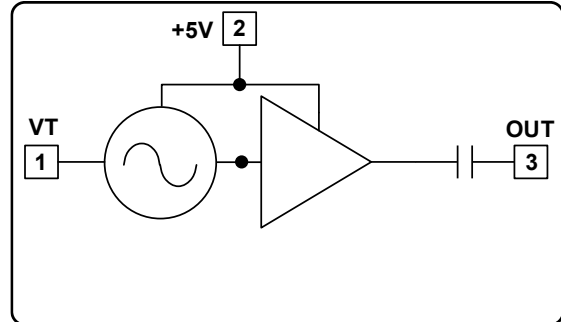
单电源供电: +5V @ 72 mA

内部集成缓冲隔离放大器

芯片尺寸: 2.1 × 2 × 0.1 mm³

可以提供裸芯片或各种类型封装或 SMA 盒体

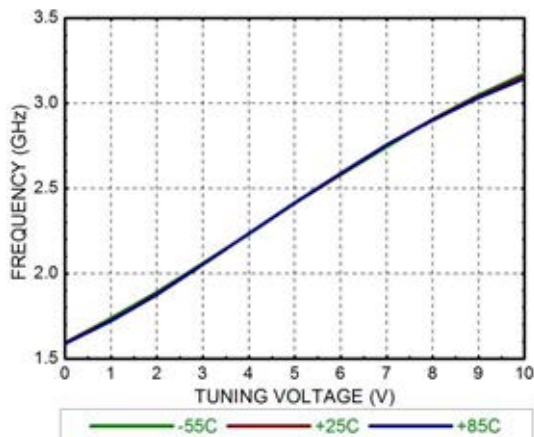
功能框图



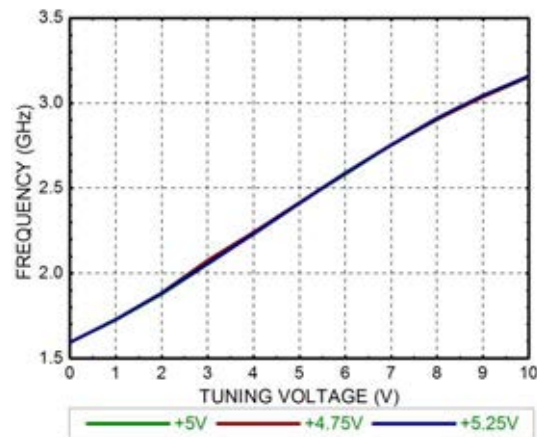
电特性参数 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = +5\text{V}$, $I_{DD} = 72\text{ mA}$)

| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|--------------------------------------|---------|-----|-----|--------|
| 频率范围 | 1.7 – 3 | | | GHz |
| 输出功率 (OUT) | | 14 | | dBm |
| 调谐电压 (VT) | 0 | | 10 | V |
| 调谐灵敏度 (KVCO) | 100 | | 180 | MHz/V |
| 工作电流 (IDD) ($V_{DD} = +5\text{V}$) | | 72 | | mA |
| 输出回波损耗 | | 10 | | dB |
| 二次谐波 | | -15 | | dBc |
| 频率漂移 | | 0.3 | | MHz/°C |

频率 vs. 调谐电压, $V_{DD}=+5\text{V}$

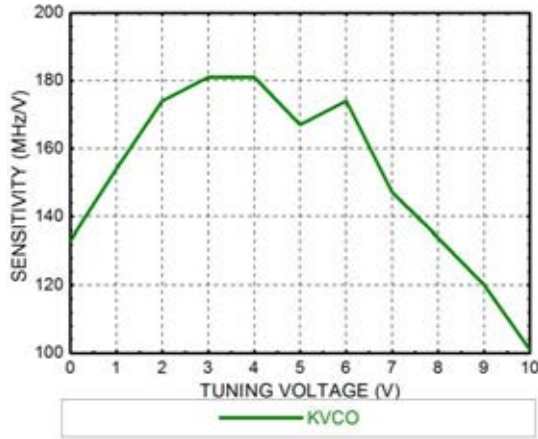


频率 vs. 调谐电压, $T=25^\circ\text{C}$

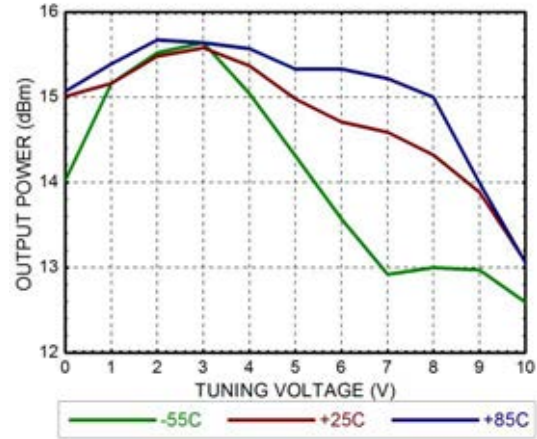




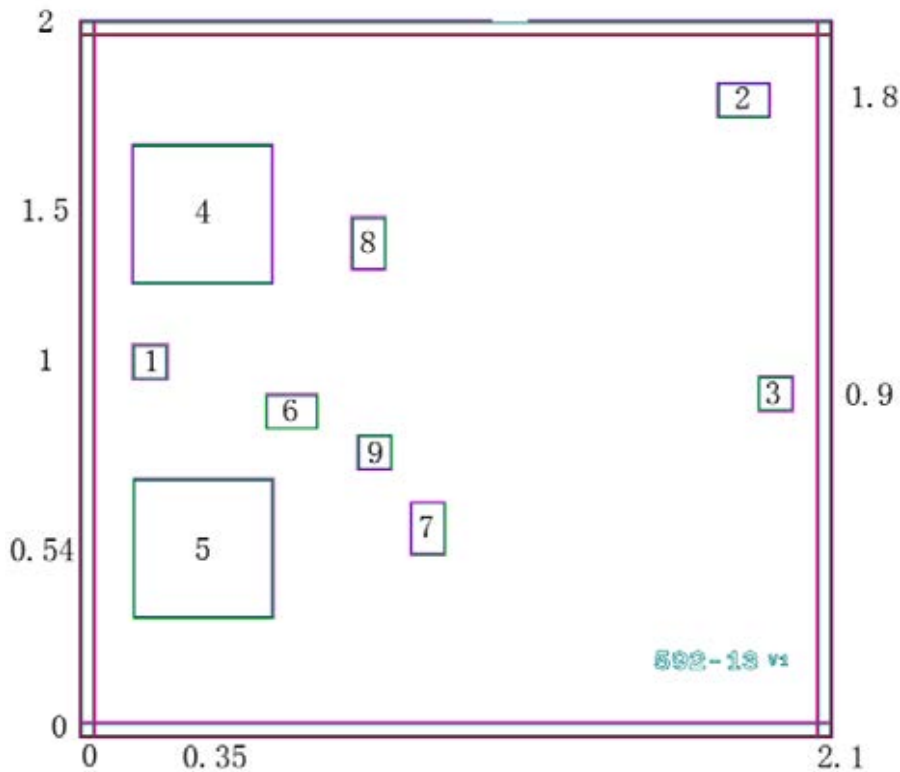
调谐灵敏度 vs. 调谐电压, $T=25^{\circ}\text{C}$



输出功率 vs. 调谐电压, $V_{DD}=+5\text{V}$

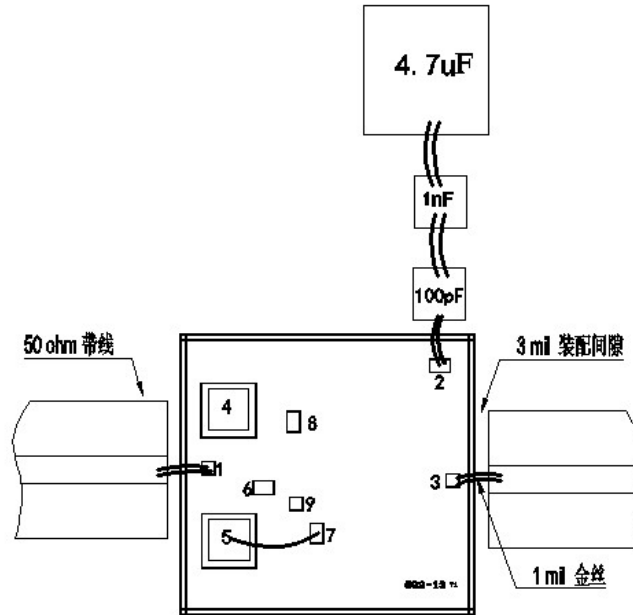


物理参数





装配图



装配说明：变容二极管通过导电胶粘接在焊盘“5”处，并将变容二极管的正极通过金丝键合到焊盘“7”处。

焊盘描述

| 焊盘序号 | 功能 | 描述 |
|------|-----|---|
| 1 | VT | 该焊盘提供 VCO 的输入控制电压 |
| 2 | +5V | 该焊盘提供 VCO 的+5V 电源，需要外接 100pF/1nF/4.7uF 旁路电容 |
| 3 | OUT | 该焊盘是 RF 输出，AC 耦合，并内部匹配至 50 Ohm |
| 5 | - | 该焊盘为变容二极管粘接处 |
| 7 | - | 该焊盘为变容管二极管正极金丝键合处 |
| 芯片背面 | GND | 芯片背面必须连接至 RF/DC 地 |

极限参数

供电电压：+6 V

储存温度：-65~+150℃

调谐电压：+20 V

工作温度：-55~+85℃